Feinlegierung **BB01**



Werkstoffbezeichnungen			
DIN-EN Symbol	CuSn0,15		
DIN-EN	CW117C		
UNS	C14415		
JIS	C1441		

Physikalische Eigenschaften*			
Elektrische Leitfähigkeit	48	MS/m	
Wärmeleitfähigkeit	360	W/(m⋅K)	
Wärmeausdeh- nungskoeffizient**	17	10-6/K	
Dichte	8,9	g/cm³	
Elastizitätsmodul	128	GPa = kN/mm²	

^{*} Richtwerte bei Raumtemperatur ** Zwischen 20 und 300 °C

Nominelle Zusammensetzung (Massengehalt in %)

Cu	Rest
Sn	0,12
Zn	< 0,1
Ni	< 0,02
Fe	< 0,02
Pb	< 0,005
P	< 0,015

Typische Anwendungen

- Aushärtbare Legierungen für Steckverbinder und Systemträger für Leistungstransistoren und Halbleiterbauelemente
- · Relaisfedern, Stanzbiegeteile
- Halbleiterträger, Steckverbinderstifte
- Systemträger
- · Elektrik im Automobil

Über den Werkstoff

bar.

Niedrig legierte Kupferlegierungen zeichnen sich durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit aus. Sie erreichen zwar nicht die Federkraft der Bronzen, sind aber gegenüber Reinkupfer deutlich härter. Daher werden sie vorwiegend für Halbleiter-systemträger, sog. Leadframes verwendet sowie für Leitungsverbinder und für die Zentralelektrik in Automobilen. BB01 ist ein niedrig mit Sn legierter Kupferwerkstoff für Leistungshalbleiter, die bei hoher Wärmeentwicklung eingesetzt werden (z.B. TO 220). BB01 unterscheidet sich von SB02 (UNS C19400) durch die höhere Wärmeleitfähigkeit und höhere elektrische Leitfähigkeit. Gegenüber Reinkupfer unterscheidet sich BB01 durch eine höhere Festigkeit bei etwas geringerer elektrischer Leitfähigkeit. BB01 ist ausgezeichnet löt- und schweiß-

Diese Legierung ist bei U.S. EPA als antimikrobiell registriert und unter der Berücksichtigung von Pb und Cd erfüllt sie die Anforderungen von OEKO-TEX Standard 100.

Mechanische Eigenschaften *)						
Zustand		O R 250 H 60	H02 R 300 H 85	H04 R 360 H 105	H06 R 420 H 120	H08 R 460 H 135
Zugfestigkeit Rm MPa		250 - 320	300 - 370	360 - 430	420 - 490	> 460
0,2% Dehngrenze Rp0,2 M	Pa	200	250	320	400	410
Bruchdehnung A _{L50} %		> 15	> 4	> 3	> 2	> 2
Härte HV		60 - 90	85 - 110	105 - 130	120 - 140	> 135
Elektrische Leitfähigkeit in	% IACS	83	83	82	82	82
Kleinster Radius des Biegestempels bei 90°-Biegung für Banddicke s, angelassene Qualität						
0,10 ≤ s ≤ 0,25 mm	rechtwinklig parallel	0 x s 0 x s	0 x s 0 x s	0 x s 0 x s	1 x s 1 x s	1,5 x s 1,5 x s
0,25 < s ≤ 0,5 mm	rechtwinklig parallel	0 x s 0 x s	0 x s 0 x s	0,5 x s 0,5 x s	1 x s 1,5 x s	-
*) Richtwerte						

Feinlegierung **BB01**



Bearbeitungshinweise	
Kaltumformen	sehr gut
Spanen	ausreichend
Galvanisieren	sehr gut
Tauchverzinnen	sehr gut
Weichlöten	sehr gut
Widerstandschweißen	gut
Schutzgasschweißen	gut
Laserschweißen	gut

Lieferbare Abmessungen

Blanke Vorwalzbänder 1 bis 2,5 mm

Präzisionsbanddicken 0,05 bis 1,2 mm

Bandbreiten 3,0 bis 600 mm, jedoch mindestens 10 x Banddicke

Größere Bandbreiten auf Anfrage

Lieferbare Ausführungen

Bänder in Ringen mit Außendurchmesser bis 1.200 mm

Gespulte Bänder mit Spulengewichten bis 1.500 kg

Multipancake bis 2,5 t

Feuerverzinnte Bänder

Profilgefräste Bänder

Galvanisch mit Zinn oder Nickel beschichtete Bänder

Ihr Ansprechpartner vor Ort

Europa

Asien





Sundwiger Messingwerk GmbH

Hönnetalstraße 110

58675 Hemer Deutschland

Tel. +49 2372 661-100

Fax +49 2372 661-48100

E-Mail: sales-sundwig@sundwiger-mw.com

www.sundwiger-mw.com

Sundwiger Metal (Shenzhen) Co. Ltd.

5F, Block 25, Shatoujiao Free Trade Zone

518081 Shenzhen

P.R. of China

Tel. +86 755 2235 7466

Fax +86 755 25260974

E-Mail: sales@sundwiger-mw.com.cn

www.sundwiger-mw.com

Die Informationen in dieser Technischen Information, die keine Garantie bestimmter Eigenschaften darstellen, wurden nach unserem besten Wissen zusammengestellt, ohne jede Verpflichtung unsererseits. Unsere Haftung wird ausschließlich durch die einzelnen Vertragsbedingungen bestimmt, insbesondere durch unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, wenn diese durch die technische Entwicklung oder Änderungen in der Verfügbarkeit erforderlich sind. Bitte fragen Sie nach der neuesten Ausgabe dieser Information.